

2020年3月期 第3四半期（2019年10月～12月） 東京エレクトロン 決算説明会

2020年1月30日

内容：

- 第3四半期 連結決算の概要 取締役 専務執行役員 布川 好一
- 事業環境および業績予想 代表取締役社長・CEO 河合 利樹



将来予想等に関する記述

- 将来見通しについて

本資料に記述されている当社の業績予想、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、経済情勢、半導体/FPD市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権に関するリスクなど、さまざまな外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

- 数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は1円単位の金額で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。

- 為替リスクについて

当社の主力製品である半導体製造装置およびFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。したがって、収益への為替レート変動による影響は極めて軽微です。

FPD：フラットパネルディスプレイ

第3四半期 連結決算の概要

2020年1月30日

布川 好一

取締役 専務執行役員 ファイナンス本部長



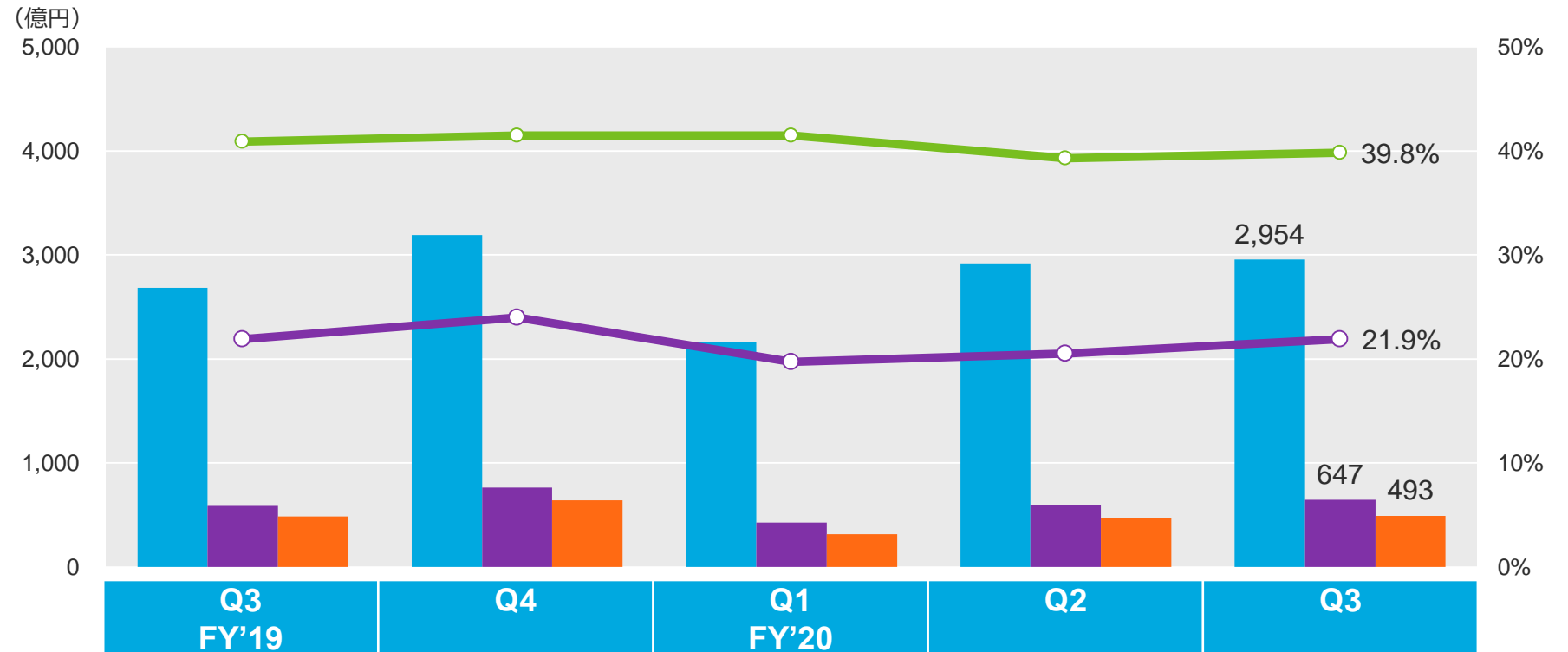
損益状況

(億円)

	FY2019		FY2020			対FY2020 Q2 増減率
	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	
売上高	2,681	3,190	2,164	2,920	2,954	+1.2%
SPE	2,395	2,887	1,981	2,718	2,820	+3.7%
FPD	285	301	182	201	133	-33.4%
売上総利益	1,097	1,322	898	1,146	1,175	+2.5%
下段：売上総利益率	40.9%	41.5%	41.5%	39.3%	39.8%	+0.5pts
販管費	510	558	473	547	528	-3.4%
営業利益	587	764	425	599	647	+8.0%
下段：営業利益率	21.9%	24.0%	19.7%	20.5%	21.9%	+1.4pts
税金等調整前当期純利益	605	798	445	620	646	+4.1%
親会社株主に帰属する 当期純利益	488	641	318	468	493	+5.3%
研究開発費	265	300	256	312	298	-4.2%
設備投資額	118	149	76	220	132	-39.9%
減価償却費	62	73	60	67	76	+13.4%

1. 当社の主力製品である半導体製造装置およびFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。
一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。
2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

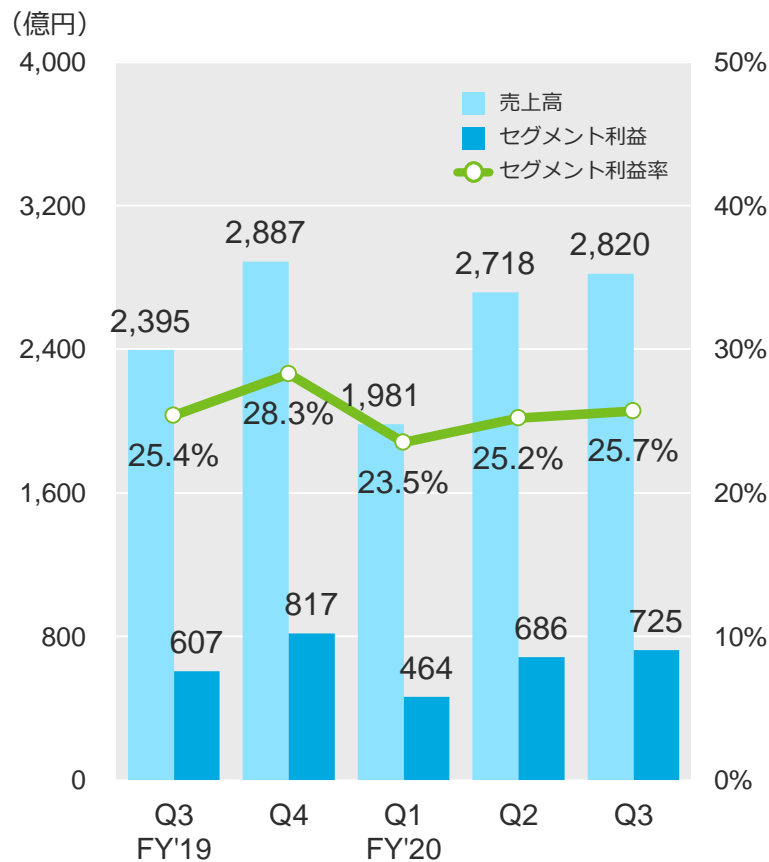
損益状況



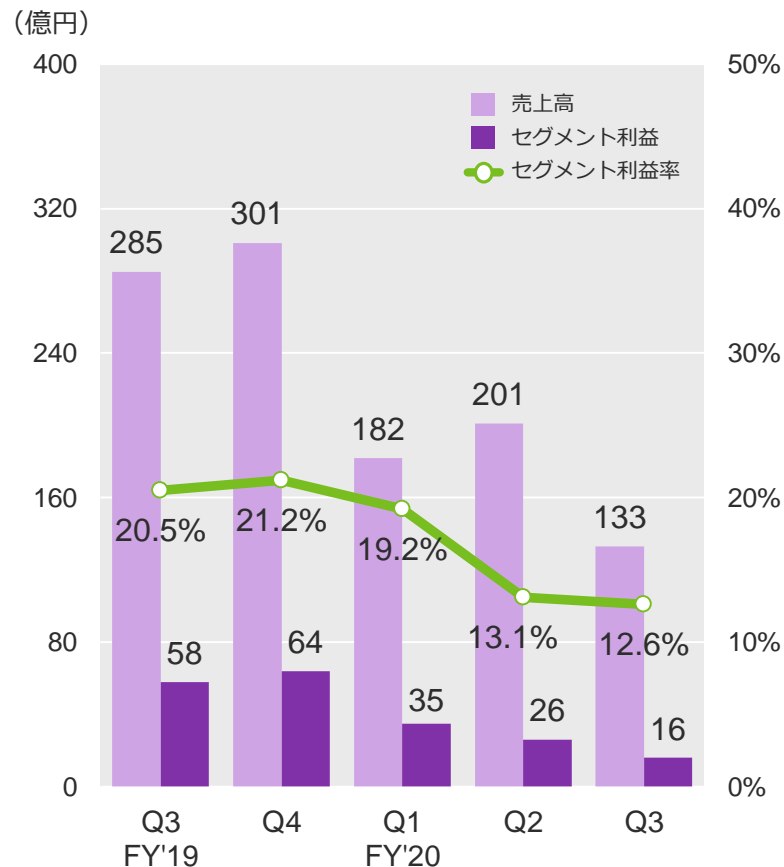
■ 売上高	2,681	3,190	2,164	2,920	2,954
■ 営業利益	587	764	425	599	647
■ 親会社株主に帰属する当期純利益	488	641	318	468	493
○ 売上総利益率	40.9%	41.5%	41.5%	39.3%	39.8%
○ 営業利益率	21.9%	24.0%	19.7%	20.5%	21.9%

セグメント情報

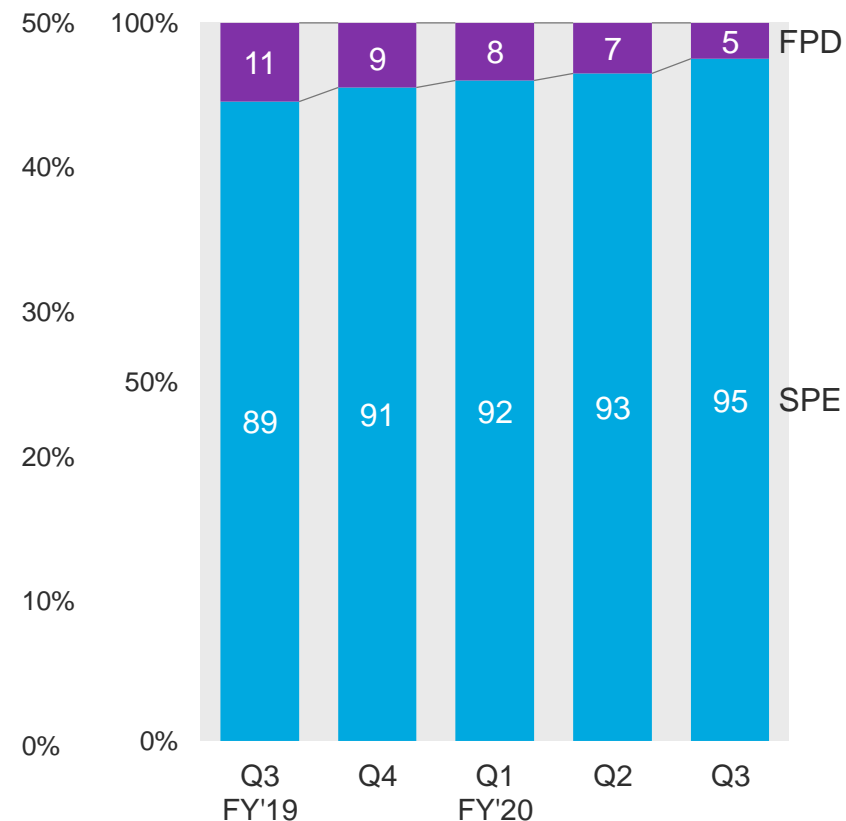
SPE (半導体製造装置)



FPD (フラットパネルディスプレイ製造装置)



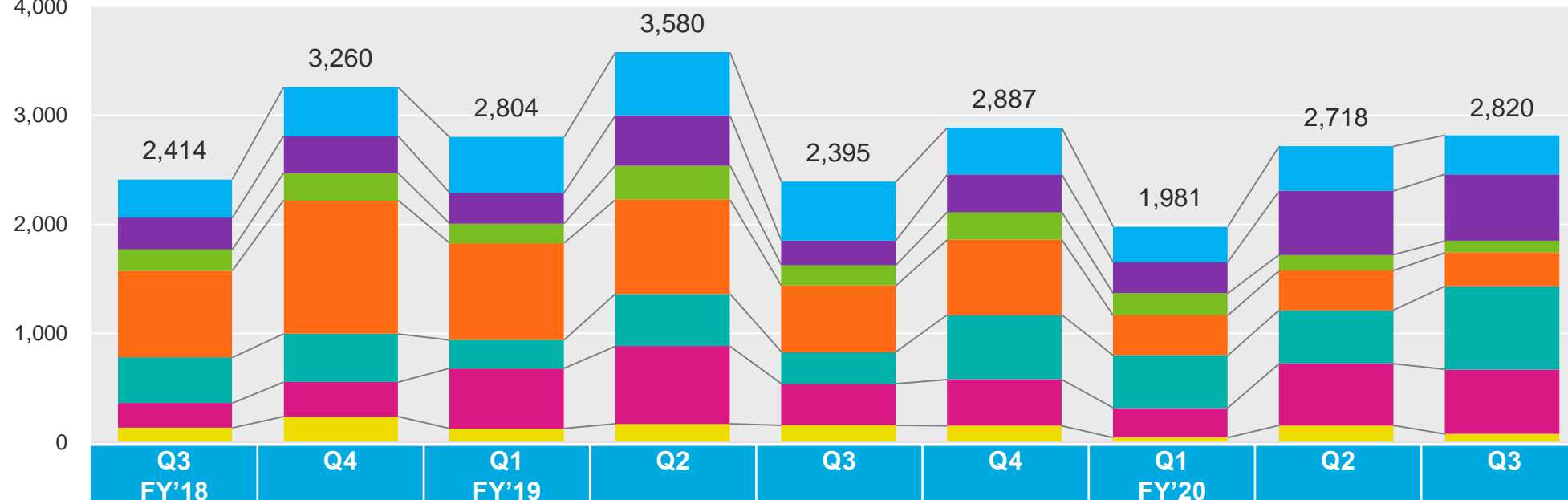
売上構成比率



1. セグメント利益は、税金等調整前当期純利益です。
2. 上記報告セグメントに配分していない基礎研究または要素研究等の研究開発費、およびその他の一般管理費等があります。
3. 売上構成比率は外部顧客に対する売上高で算出しています。

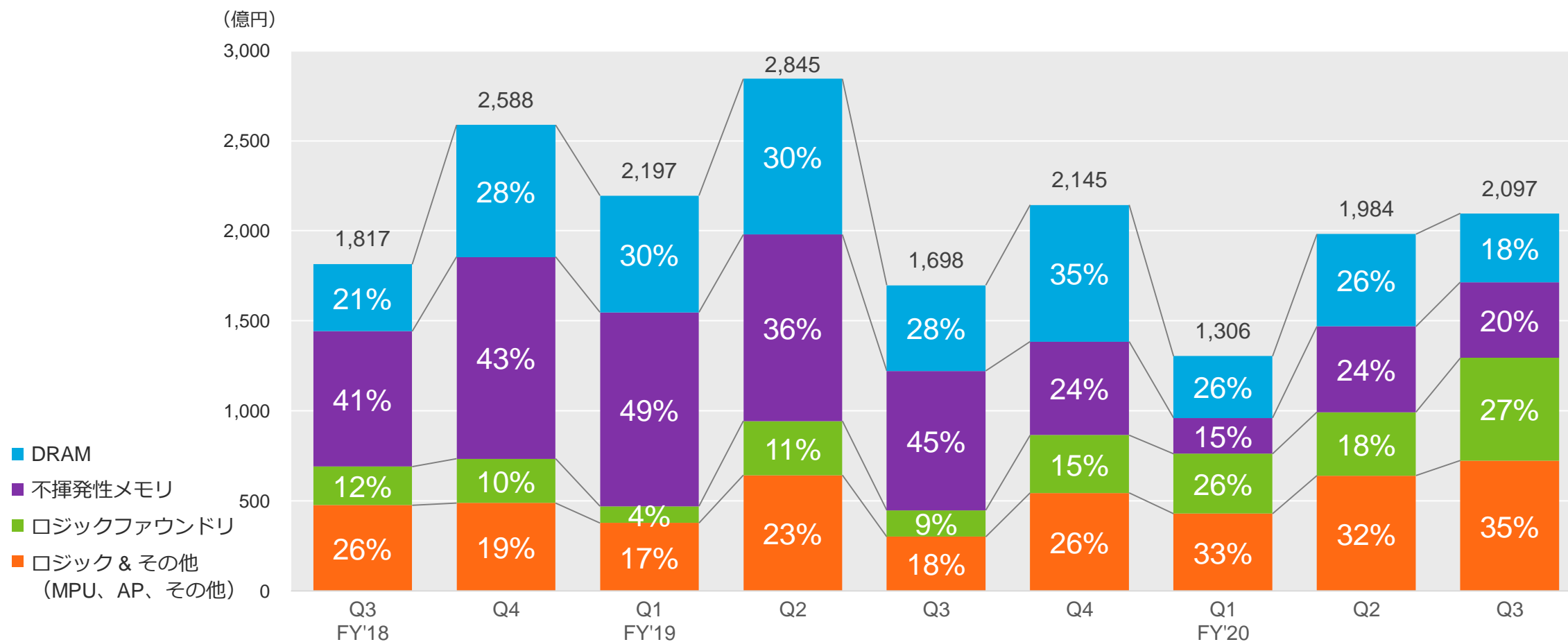
SPE部門 地域別売上高

(億円)
4,000



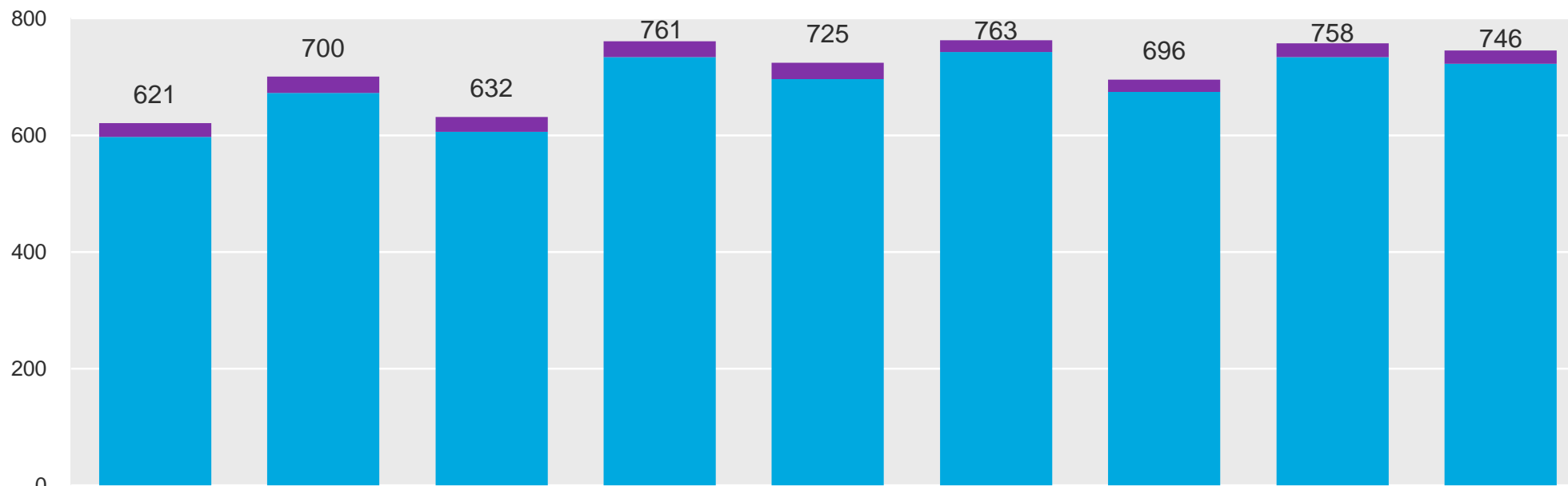
	Q3 FY'18	Q4	Q1 FY'19	Q2	Q3	Q4	Q1 FY'20	Q2	Q3
日本	351	451	511	580	540	427	325	410	359
北米	291	339	284	459	227	347	285	588	610
欧州	196	250	177	313	186	253	202	144	108
韓国	794	1,223	889	865	609	689	369	364	310
台湾	421	443	263	480	293	591	483	487	762
中国	226	318	549	713	380	425	270	568	591
東南アジア・他	132	234	127	168	156	152	44	155	77

SPE部門 新規装置 アプリケーション別売上構成比



フィールドソリューション売上高

(億円)

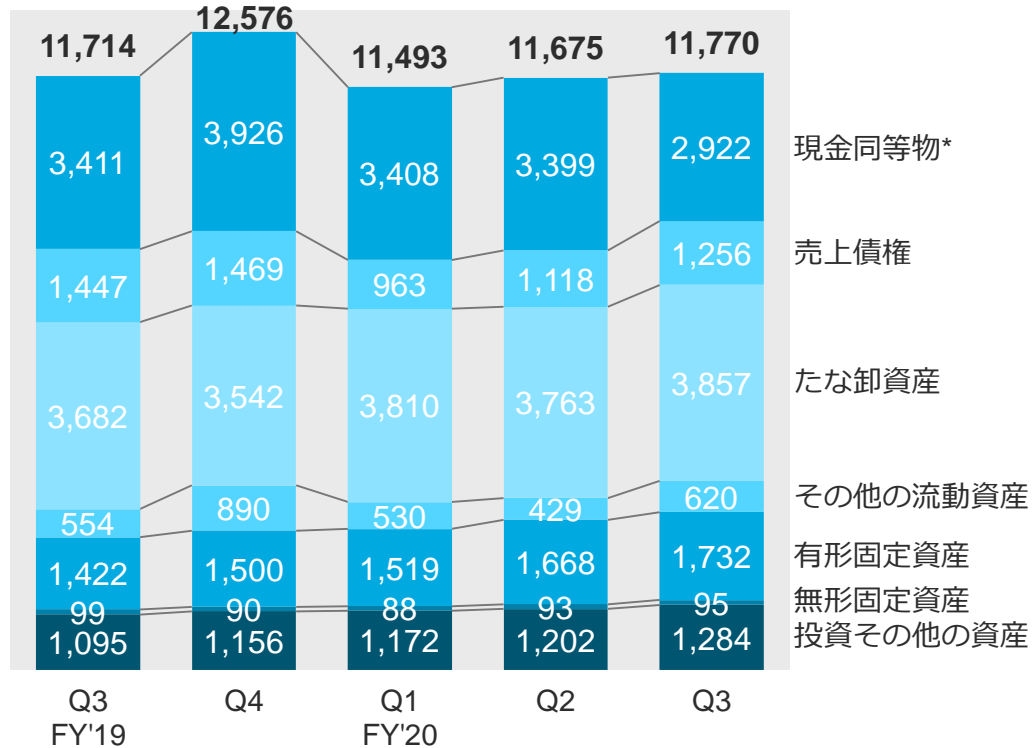


	Q3 FY'18	Q4	Q1 FY'19	Q2	Q3	Q4	Q1 FY'20	Q2	Q3
SPE売上高	597	672	606	734	696	742	674	734	722
FPD売上高	24	28	25	27	28	21	21	23	23

貸借対照表

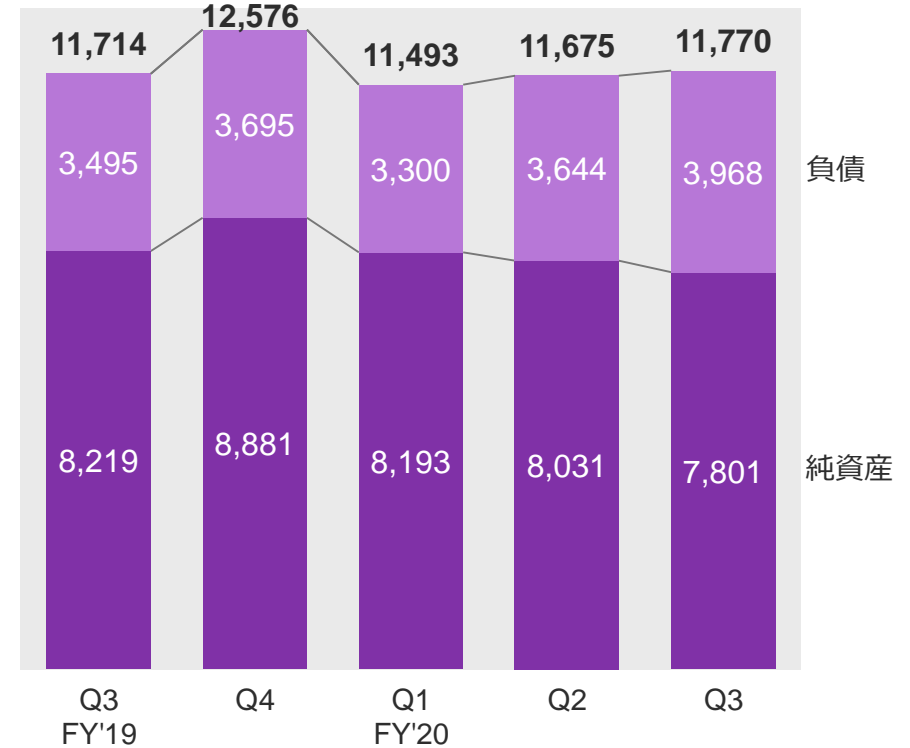
資産

(億円)

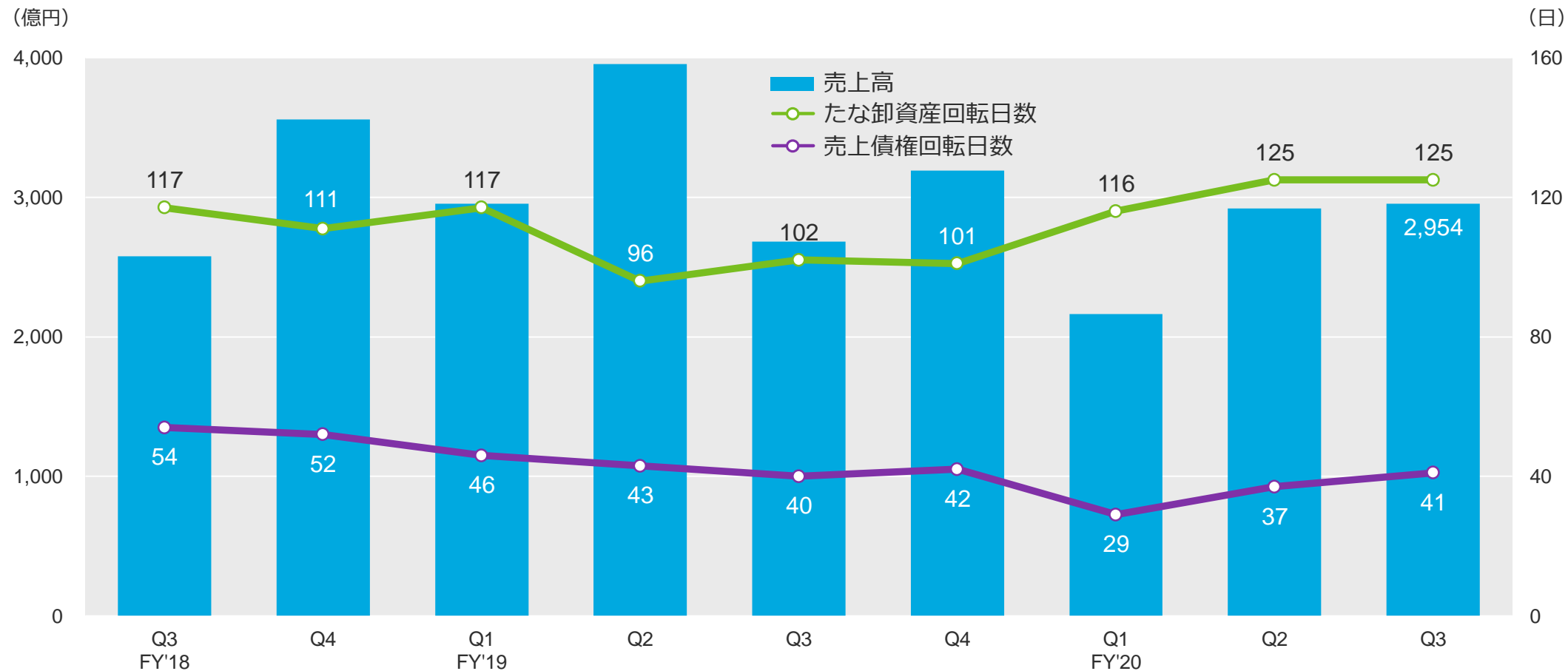


負債・純資産

(億円)

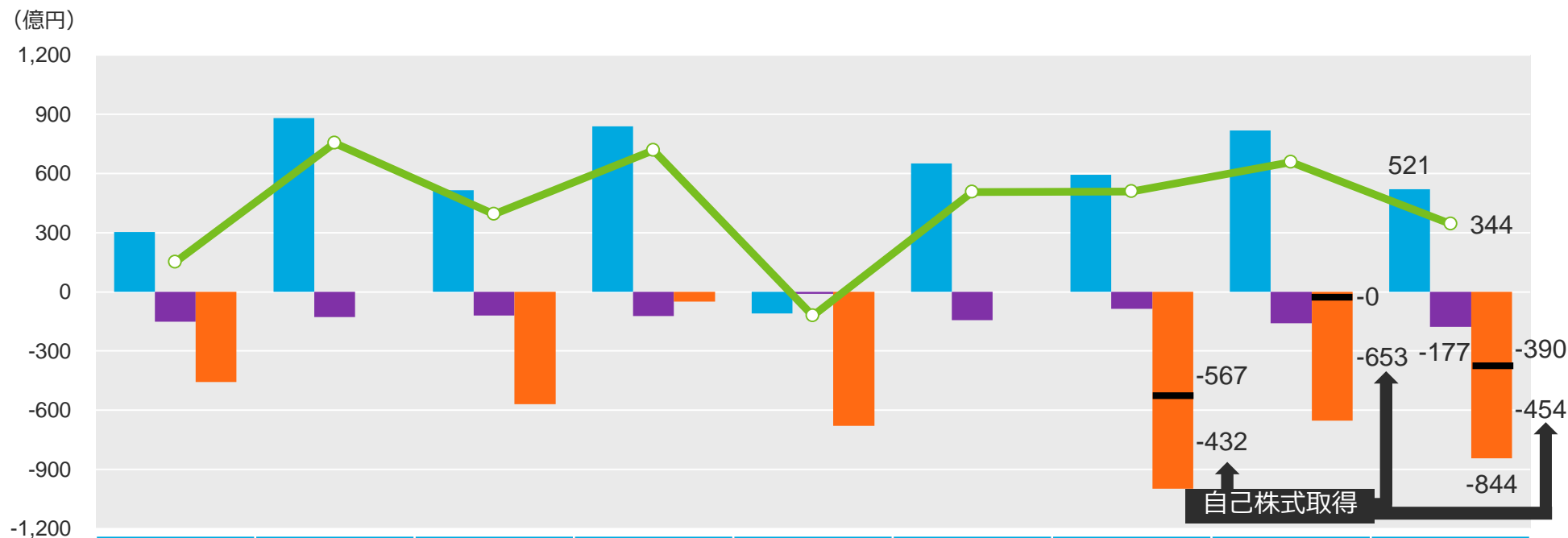


たな卸資産・売上債権の回転日数



回転日数 = 売上債権もしくはたな卸資産 ÷ 各四半期末までの12ヶ月間売上高 × 365

キャッシュ・フロー



	Q3 FY'18	Q4	Q1 FY'19	Q2	Q3	Q4	Q1 FY'20	Q2	Q3
営業キャッシュ・フロー	304	881	514	840	-110	650	594	817	521
投資キャッシュ・フロー*1	-152	-128	-121	-122	-11	-144	-85	-158	-177
財務キャッシュ・フロー	-457	-0	-569	-50	-678	-0	-999	-654	-844
フリーキャッシュ・フロー*2	151	753	393	717	-121	505	509	658	344
手元資金残高*3	3,012	3,738	3,555	4,237	3,411	3,926	3,408	3,399	2,922

*1 投資キャッシュ・フローは、満期3ヶ月超の預金等の増減額を除いた金額です。

*2 フリーキャッシュ・フロー = 営業活動によるキャッシュ・フロー + 投資活動によるキャッシュ・フロー (満期3ヶ月超の預金等の増減額を除く)

*3 手元資金とは、現金及び現金同等物と満期3ヶ月超の預金等の合計金額です。

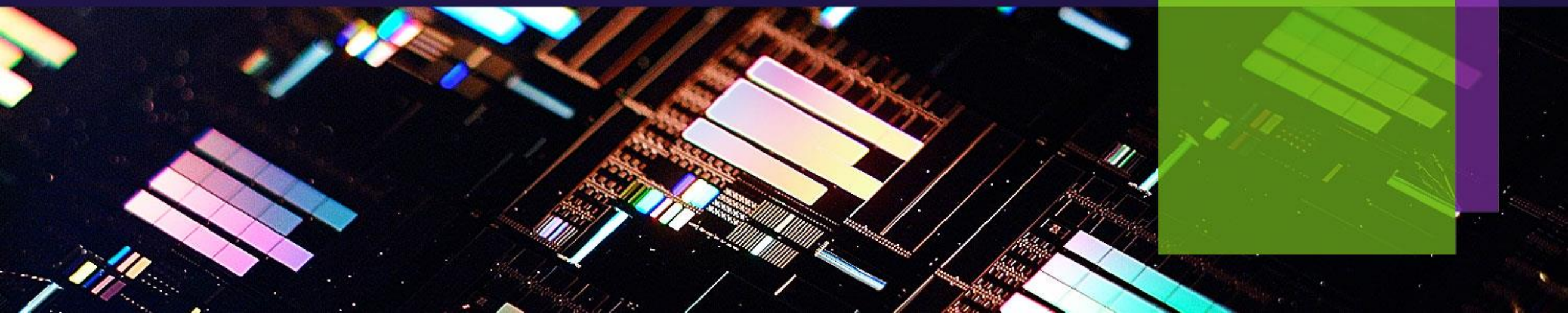
自己株式の取得が完了・消却を決定

- 2019年5月に発表した自己株式の取得が、2019年12月末で完了
 - 取得した株式の総数：8,392,000株
 - 取得価額の総額：149,999,373,492円
- 自己株式8,000,000株の消却を決定
 - 消却前の発行済株式の総数に対する割合：4.84%
 - 消却後の発行済株式の総数：157,210,911株
 - 取得数との差分の392,000株は、新株予約権（株式報酬型ストックオプション）に使用予定

事業環境および業績予想

2020年1月30日

河合 利樹
代表取締役社長・CEO



事業環境（2020年1月時点での見方）

▶ 半導体前工程製造装置(WFE)*1の設備投資

CY2020は、ロジック/ファウンドリ向け投資が前年に引き続き高い水準を維持、加えてメモリ向け投資が回復局面に転じると予想。全体として前年比増加を見込む

▶ FPD製造装置 TFTアレイ工程*2向け設備投資

CY2020は、第6世代および第8.5世代OLED（モバイル、TV向け）の投資増加に加え、第10.5世代LCD投資も引き続き見込まれ、前年比15%程度の増加を予想

*1 半導体前工程製造装置（WFE; Wafer fab equipment）：半導体製造工程には、ウェーハ状態で回路形成・検査をする前工程と、そのウェーハをチップごとに切断し、組み立て・検査をする後工程があります。半導体前工程製造装置は、この前工程で使用される製造装置です。また半導体前工程製造装置は、ウェーハレベルパッケージング用の装置を含んでいます。

*2 TFTアレイ工程：ディスプレイを駆動する電気回路機能を持つ基板を製造する工程

CY2020 アプリケーション別のWFE市場と事業機会

■ ロジック/ファウンドリ

- 市場環境：最先端から14nmまでの世代を中心に、CY2019に引き続き、高い水準を維持
- 事業機会：難易度の高まるパターンニングでのビジネス拡大

■ 不揮発性メモリ

- 市場環境：在庫調整が進み、メモリ価格が上昇基調に反転。段階的な投資再開を見込む。9X層から12X層への移行に伴う投資が増加
- 事業機会：高付加価値のエッチング・洗浄工程での差別化

■ DRAM

- 市場環境：メモリ価格が下げ止まり、年前半には在庫が適正化されることにより、今後の投資再開を期待。設備投資の約8割が1Y/1Znm世代向け
- 事業機会：最先端世代における一括パターンニング

WFE市場の本格回復に向けて対応

FY2020 事業進捗 (Q1~Q3)

■ SPEの事業戦略は計画通り進捗

- 注力分野で POR*1の獲得が進む
 - エッチング：拡大するIoT・Automotive分野でPOR獲得、受注増加
 - 成膜：メモリ向けクリティカル工程に加えて、先端ロジックにおいてもPOR獲得が進む
 - 洗浄：ベベル洗浄装置の展開が順調に進捗。新機種の受注も拡大
- フィールドソリューションは、インストールベースの増加に伴い、WFE市場の調整局面においても引き続き好調

■ FPD製造装置の新製品の販売が順調に進む

- 高精細FPD向け第10.5世代プラズマエッチング装置 Impressio™ 3300 PICP*2™
- 有機ELディスプレイ製造用インクジェット描画装置 Elius™

*1 POR (Process of record) : 顧客の半導体製造プロセスにおける装置採用の認定

*2 PICP : パネル基板上に極めて均一な高密度プラズマを生成するプラズマソース

FY2020 業績予想

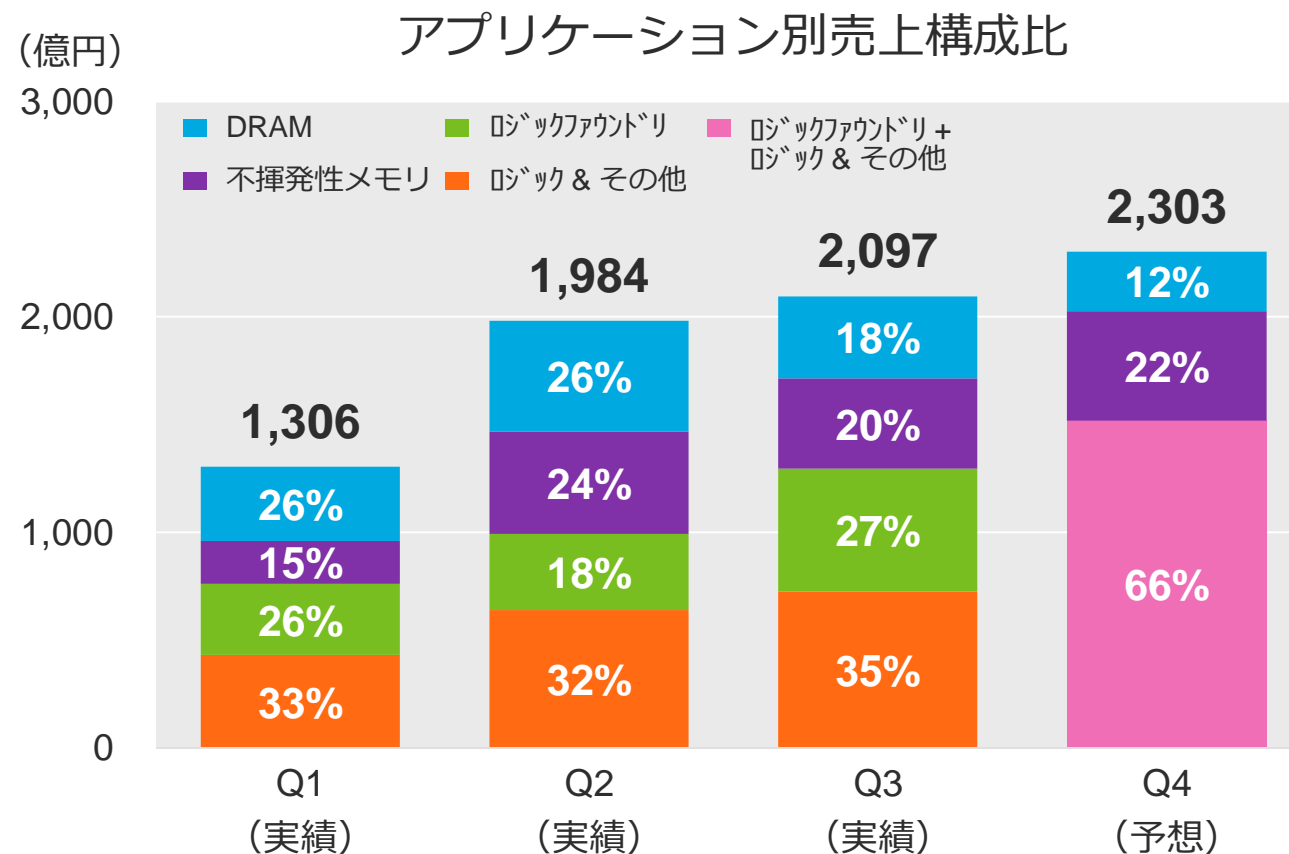
FY2020 業績予想 (2019/10/31発表から変更なし)

(億円)

	FY2019 (実績)	FY2020 (予想)			
		H1	H2	通期	通期 対前年増減
		実績	予想	予想	
売上高	12,782	5,084	6,015	11,100	-13.2%
SPE	11,667	4,700	5,649	10,350	-11.3%
FPD	1,112	383	364	748	-32.8%
売上総利益	5,261	2,045	2,404	4,450	-811
下段：売上総利益率	41.2%	40.2%	40.0%	40.1%	-1.1pts
販管費	2,156	1,020	1,179	2,200	+43
営業利益	3,105	1,024	1,225	2,250	-855
下段：営業利益率	24.3%	20.2%	20.4%	20.3%	-4.0pts
税金等調整前当期純利益	3,215	1,066	1,223	2,290	-925
親会社株主に帰属する 当期純利益	2,482	787	912	1,700	-782
1株当たり当期純利益 (円)	1,513.58	490.18	-	1,074.47	-439.11

業績予想に対して、順調に進捗

FY2020 SPE部門 新規装置売上予想

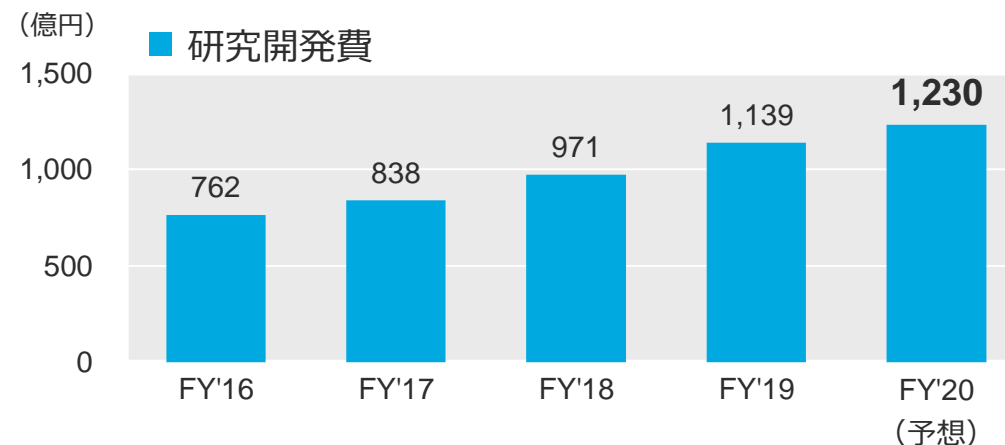


ロジック/ファウンドリ向けは引き続き堅調
メモリ向け売上の増加は来期に見込む

グラフは新規装置の売上高における構成比を示しています。フィールドソリューション売上高を含んでいません。

FY2020 研究開発費・設備投資計画 (2019/10/31発表から変更なし)

- 開発費 1,230億円
 - 注力分野および持続的成長を見据えた投資継続
- 設備投資 560億円
 - 先端技術開発・増産対応への積極的な投資
- 減価償却費 330億円



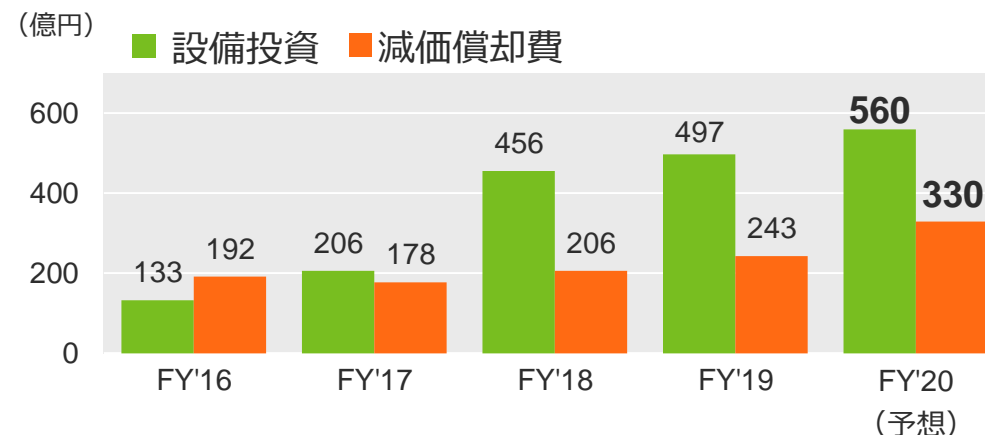
新生産棟の建設
(成膜装置・ガスケミカルエッチング装置・テストシステム)



山梨県富士崎市：建設費約130億円
(2020年8月 稼動開始予定)

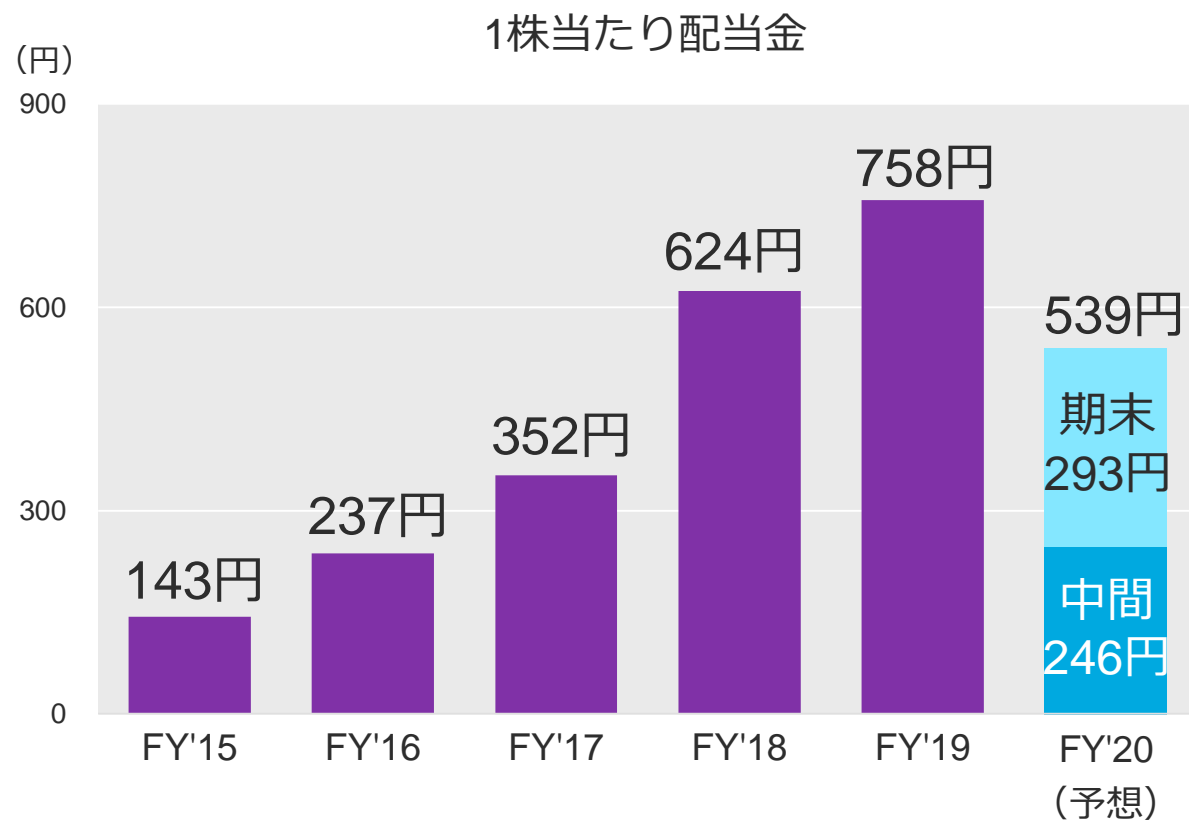


岩手県奥州市：建設費約130億円
(2020年7月 稼動開始予定)



中期計画達成とさらなる成長を視野に先行投資を継続

FY2020 配当予想



当社の株主還元策

連結配当性向： 50%

但し、1株当たり年間配当金150円を下回らない

2期連続して当期利益を生まなかった場合は、配当金の見直しを検討する

自己株式の取得： 機動的に実施を検討

下期の自己株式取得に基づき、期末配当予想を修正

TEL™

TOKYO ELECTRON